

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION

Publication 317-5A

1972

Complément A

Décembre 1972

à la Publication 317-5
(Première édition — 1970)

Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage

Cinquième partie: Fils de section circulaire
en cuivre émaillé à hautes propriétés mécaniques,
adhérent sous l'action de la chaleur ou de solvant

Le complément contenu dans la présente publication a été
approuvé suivant la Règle des Six Mois.

Un projet, document 55(Bureau Central)42, fut discuté par
le Comité d'Etudes N° 55 et fut diffusé en octobre 1967 pour
approbation suivant la Règle des Six Mois.

Un projet révisé, document 55(Bureau Central)75, fut dif-
fusé pour approbation suivant la Procédure des Deux Mois
en janvier 1970.

Supplement A

December 1972

to Publication 317-5
(First edition — 1970)

Specifications for particular types of winding wires

Part 5: Heat or solvent bonding enamelled round
copper wire with high mechanical properties

The supplement contained in this publication has been
approved under the Six Months' Rule.

A draft, Document 55(Central Office)42, was discussed by
Technical Committee No.55 and was circulated for approval
under the Six Months' Rule in October 1967.

A revised draft, Document 55(Central Office)75, was cir-
culated for approval under the Two Months' Procedure in
January 1970.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca-
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse